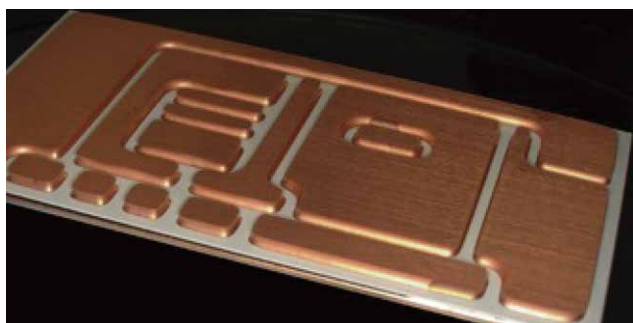


パワーモジュール対応メタルベース放熱基板

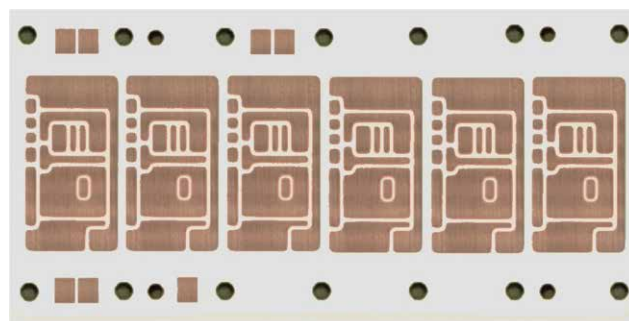
Metal base PWB for Power Module application

特長 Features

- ✓ パワーモジュール用途に最適な、低熱抵抗、高耐圧かつ扱い易い絶縁構造材料をご提案
Good materials for Power Modules with low Rth, high Breakdown voltage, and easy handling
- ✓ 高熱容量、大電流を実現する回路銅厚1.0mm仕様
Up to 1.0mm Cu trace for higher heat capacity and larger electric current
- ✓ 各種ベース金属に対応し、用途に応じた表面処理を適用
Various surface finishes onto Cu or Al for reliable power module products



電極銅厚1.0mm



6 in 1タイプ 大判化



高耐熱ニッケルめっき表面処理



ピンフィン一体構造による低熱抵抗化

材料ラインナップ Material line-up for Power Module application

特性値	単位	H5	H7T	H10	H10C	H16
熱伝導率	W/m・K	5	7	10	10	16
厚さ	μm	100	80	100	115	150
ガラス転移温度	℃	>300	200	>300	—	200
絶縁破壊電圧	AC kV	4	4	4	5	5
特長	—	高耐熱	高耐熱	高耐熱	低弾性	高放熱